

# 第92期株主通信

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

## 株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。当社の第92期株主通信をお届けするにあたり、ご挨拶を申し上げます。

当社グループは、半導体製造装置および計測機器メーカーとして、お客様の生産性向上に寄与する最先端の製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。企業成長の必須条件である「安全・健康」、「品質」、「環境・省エネルギー」、「全員力」を行動指針として、これまで培ってきた精密測定技術と精密加工技術を活かし、優れた半導体製造装置と計測機器を開発・供給することを通じ、お客様、株主の皆様、従業員、地域社会、国際社会など広く社会に貢献してまいります。



代表取締役社長 CEO

荒田 均

### 当期の概況

当社をとりまく内外経済情勢は、米国では緩やかな景気回復傾向が続いた一方、欧州の景気は足踏み状態が続き、アジア新興国の成長ペースは鈍化傾向となりました。国内は消費税率引き上げに伴う個人消費低迷が見られたものの、企業収益や雇用の改善などで持ち直し、緩やかな回復に向かいました。このような状況下、連結業績は、主要ユーザーである半導体関連業界、自動車関連業界の活発な設備投資動向を受け、前期比増収増益となりました。受注高 702億41百万円（前期比21.8%増）、売上高は 664億45百万円（前期比20.2%増）となり、利益面は、営業利益 121億24百万円（前期比43.2%増）経常利益は 127億91百万円（前期比41.8%増）で、この結果、当期純利益は 89億93百万円（前期比53.5%増）となりました。

### 次期の見通し

#### 〈半導体装置部門〉

半導体市場の最大の牽引役は引き続きスマートフォンやその周辺デバイスと見込まれ、これに関わる高機能化などの技術動向や需要動向が半導体メーカーや電子部品メーカーの設備投資動向を大きく左右するものと考えられます。開発、生産に対応する装置へのニーズも更に高度化、多様化しております。加えて、スマートフォンに続く成長分野と目されるIoT<sup>\*</sup>、クラウドコンピューティングに対応したストレージ、通信インフラ機器向けデバイスや車載デバイスなど今後の市場拡大の可能性を有する分野もあります。当社は顧客ニーズに合った製品の開発や複合機化などを進めることで、多方面に亘る設備投資ニーズをきめ細かく取り込むとともに新たな市場開拓を行なってまいります。（※Internet of Things：モノのインターネット）

#### 〈計測機器部門〉

主要ユーザーである自動車関連業界は、東南アジア、北中南米など海外中心に設備投資を積極的に計画、実施しており、引き続き海外市場主体に設備増強を進めるものと見込んでおります。また、回復が鮮明となった工作機械や堅調な推移を続ける航空機などの業種における設備投資需要も期待されます。このような状況下、当社は高精度・高機能化の要請に応える製品開発を行ないフルラインナップ化を進めてまいります。需要拡大が見込める中国、東南アジア、北中南米など海外地域での人員、拠点網、代理店網の充実を図ってまいります。更に、新たな製品領域として立ち上げた光学測定機器製品の早期周知を図り、従来以上にきめ細かくお客様のニーズを汲み上げ、お客様満足の上と一層の市場開拓を進めてまいります。

### 利益配分に関する基本方針

当期末の配当につきましては、当期の業績等を総合的に勘案し株主の皆様のご支援にお応えするため、平成27年2月12日に公表しました配当予想1株当たり26円から7円増配し、33円とさせていただきます。この結果当期の1株当たり年間配当金は、中間配当金22円と合わせ、前期に比べて32円増配の55円となりました。

次期以降の配当政策につきましては、業績に連動した利益配分を実施することを基本に、連結配当性向25%程度を目安として実施していく考えです。また、安定的・継続的に配当を行なうよう努めていく観点から、連結利益水準にかかわらず年20円の配当は維持してまいります。

（但し2期連続赤字になる場合は、見直す可能性があります。）

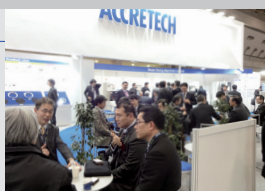
## 展示会

### 半導体関連

#### SEMICON Japan 2014

日時：2014年12月3日（水）～12月5日（金）  
会場：東京ビッグサイト

新型ブレードダイサのラインナップ実機展示を中心に、ブレードで加工した電子部品のサンプルウェーハや、TSV向けの当社製品のラインナップパネルなどの展示を行いました。展示会全体で昨年以上の入場者数を記録しました。



### 計測関連

#### JIMTOF 2014

日時：2014年10月30日（木）～11月4日（火）  
会場：東京ビッグサイト

SURFCOM NEXとRONDCOM NEXにロボット搬送をつけた粗さ・真円度の自動測定の実演が注目を集め、新製品の中でも特に非接触三次元表面粗さ・形状測定機「Opt-scope」の説明が多くのお客様の興味を惹きました。



# 連結財務諸表

注：連結財務諸表の数値は百万円未満を切り捨てて表示しています。

## 連結貸借対照表

単位：百万円

科目	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
《資産の部》		
流動資産	55,865	67,873
固定資産	26,699	30,584
有形固定資産	18,769	20,359
無形固定資産	1,426	1,125
投資その他の資産	6,503	9,098
資産合計	82,565	98,457
《負債の部》		
流動負債	15,571	21,718
固定負債	2,324	2,367
負債合計	17,896	24,085
《純資産の部》		
株主資本	62,158	69,820
資本金	10,238	10,295
資本剰余金	21,255	21,312
利益剰余金	30,776	38,325
自己株式	△ 111	△ 113
その他の包括利益累計額	2,071	3,995
新株予約権	320	385
少数株主持分	118	169
純資産合計	64,668	74,371
負債純資産合計	82,565	98,457

## 連結損益計算書

単位：百万円

科目	前連結会計年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
売上高	55,268	66,445
売上原価	34,845	40,275
売上総利益	20,422	26,169
販売費及び一般管理費	11,956	14,044
営業利益	8,466	12,124
営業外収益	626	726
営業外費用	68	59
経常利益	9,024	12,791
特別利益	79	9
特別損失	12	4
税金等調整前当期純利益	9,090	12,796
法人税等	3,201	3,767
少数株主損益調整前当期純利益	5,889	9,028
少数株主利益	30	35
当期純利益	5,858	8,993

## 連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

科目	前連結会計年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,434	10,820
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,374	△ 2,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,244	△ 1,762
現金及び現金同等物に係る換算差額	292	265
現金及び現金同等物の増減額	2,107	6,363
現金及び現金同等物の期首残高	18,147	20,411
連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額	157	—
現金及び現金同等物の期末残高	20,411	26,775

## 会社概要

(平成27年3月31日現在)

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)
設立	1949年3月28日
資本金	10,295百万円
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部
会社が発行する株式の総数	110,501,100株
発行済株式の総数	41,340,681株 (うち、自己株式数34,609株)
株主数	20,135名
役員	代表取締役会長 太田 邦正 代表取締役社長 CEO 吉田 均 代表取締役副社長 COO 木村 龍一 代表取締役 CFO 川村 浩一 取締役 速藤 章宏 取締役 友枝 雅洋 取締役 伯耆田 真浩 取締役 梅中 茂 取締役 ウォルフガング・ボナツ 取締役(社外) 松本 弘一 取締役(社外) 齋藤 昇三 監査役 澤田 栄夫 監査役(社外) 菊池 克治 監査役(社外) 井上 直美 監査役(社外) 林 芳郎

国内拠点	業務会社 半導体社 計測社 半導体関連営業所 計測関連営業所 グループ会社	東京都八王子市 東京都八王子市 茨城県土浦市 3ヶ所 14ヶ所 5社22拠点
海外拠点	北米・南米 ヨーロッパ アジア	8ヶ所 5ヶ所 53ヶ所

### 株式の状況

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	4,063	9.8
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9)	1,532	3.7
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	1,276	3.1
公益財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.6
株式会社ツガミ	1,033	2.5

### 所有者別状況

(株式数比率)



## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日～翌年3月31日
剰余金の配当 基準日	3月31日 (中間配当を行う場合は9月30日)
定時株主総会	毎年6月中
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
株式お手続き お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 TEL：0120-288-324(フリーダイヤル)
公告方法	電子公告(ホームページ) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

### 従業員数

1,447名

### 主要取引銀行

みずほ銀行 大手町営業部  
三井住友銀行 本店営業部  
みずほ信託銀行 本店営業部  
三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店  
商工組合中央金庫 東京支店  
常陽銀行 土浦支店  
筑波銀行 本店  
八千代銀行 本店

TOKYO SEIMITSU

http://www.accretech.jp